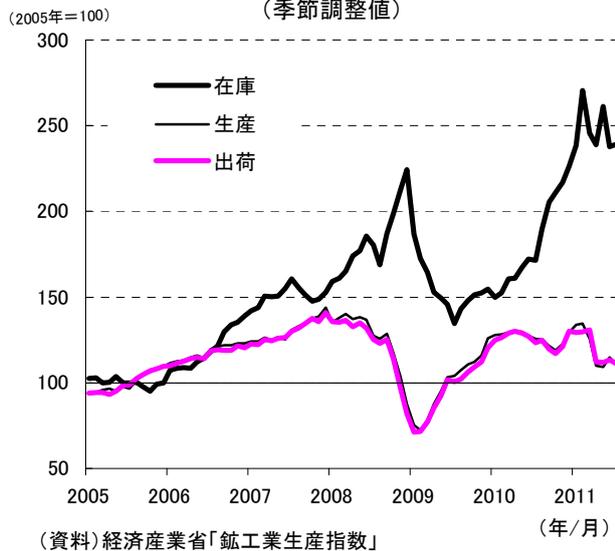


回復が遅れるわが国の電子部品・デバイス生産

- (1) 震災以降、わが国の電子部品・デバイス生産は弱含みが持続（図表1）。生産計画をみても、8～9月も減産の見込み。生産が急回復に転じている自動車・一般機械などとは対照的な動き。
- (2) 品目別にみると、携帯電話などに搭載されるアクティブ型液晶素子（中・小型）など一部の品目では震災前の生産水準を回復しているものの、主要な電子部品・集積回路は低迷しており、震災前の8割程度にとどまる状況（図表2）。
- (3) 在庫が高水準であることを勘案すると、生産弱含みの主因は、供給制約ではなく、需要低迷の公算大。そこで内外別の出荷内訳をみると、国内向け出荷がほぼ横ばいにとどまる一方、輸出向け出荷は2010年初をピークに失速が顕著（図表3）。

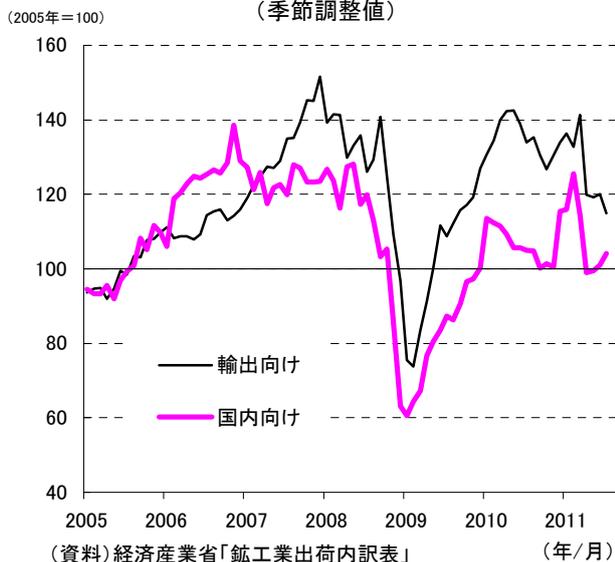
(図表1) 電子部品・デバイスの生産・出荷・在庫
(季節調整値)



(図表2) 品目別にみた電子部品・デバイスの生産水準
(2011年7月)

品目	ウエイト	生産水準
電子部品・デバイス	1000	82
電子部品	478	85
抵抗器	14	94
固定コンデンサ	54	85
トランス	6	89
水晶振動子・複合部品	24	82
超小形電動機	3	76
通信・電子装置用スイッチ	11	88
コネクタ	47	80
電子回路基板	95	82
磁気テープ	14	84
光ディスク	6	90
スイッチング電源	12	90
PDPモジュール	32	-
アクティブ型液晶素子(大型)	61	81
アクティブ型液晶素子(中・小型)	92	101
パッシブ型液晶素子	8	103
半導体素子	72	75
シリコンダイオード	5	49
整流素子	8	86
トランジスタ	29	74
発光ダイオード	14	82
レーザダイオード	11	59
カプラ・インタラプタ	6	94
集積回路	395	78
線形半導体集積回路	51	81
バイポーラ型半導体集積回路	4	103
モス型半導体集積回路(マイコン)	78	76
モス型半導体集積回路(ロジック)	137	91
モス型半導体集積回路(メモリ)	64	67
モス型半導体集積回路(CCD)	31	84
混成集積回路	29	90
半導体部品	55	91
シリコンウエハ	55	91

(図表3) 電子部品・デバイスの出荷内訳
(季節調整値)



(資料) 経済産業省「鉱工業生産指数」

(注) 生産水準は震災前(2011年2月)を100として指数化したもの。

(4) もっとも、電子部品・デバイスの世界市況は、台湾・韓国の生産が増勢を維持するなど、顕著な落ち込みはみられず(図表4)。こうした状況を踏まえると、わが国の電子部品・デバイスは“ひとり負け”の様相。

(5) この背景として、円高による輸出競争力の低下を指摘可能(図表5)。差別化の図れていない汎用品を中心に輸出が伸び悩んだ結果、在庫が積み上がり、生産へのマイナス圧力として作用している公算大。

(6) 今後を展望しても、円高地合いが続くと予想されることに加え、世界経済の減速懸念も強まっているため、電子部品・デバイス生産の回復は期待薄。ちなみに、半導体生産に対し先行性を持つといわれる半導体製造装置のBBレシオ(受注額/出荷額)は、2011年入り後、好不調の目安である1.00を割り込んで推移しており、生産活動の低迷を示唆(図表6)。

